

プリント基板用 クロムマスク

【概要】

近年、電子機器の小型化、軽量化、高機能化に伴い、FC-BGAなどの半導体パッケージ基板の高密度化が急速に進んでおり、この動きは、今後さらに加速すると思われれます。DNPでは、この高密度PKG基板の高歩留りを実現するため、LSI用フォトマスク製造で培った加工技術をベースに、高信頼性かつ耐久性に優れたクロムマスクの製造、供給を手がけております。

【効果】

- 微細パターンの実現
- 高い耐久性による実質的コスト削減
- ペリクル装着によるリソグラフィ工程でのゴミ対策、歩留り向上

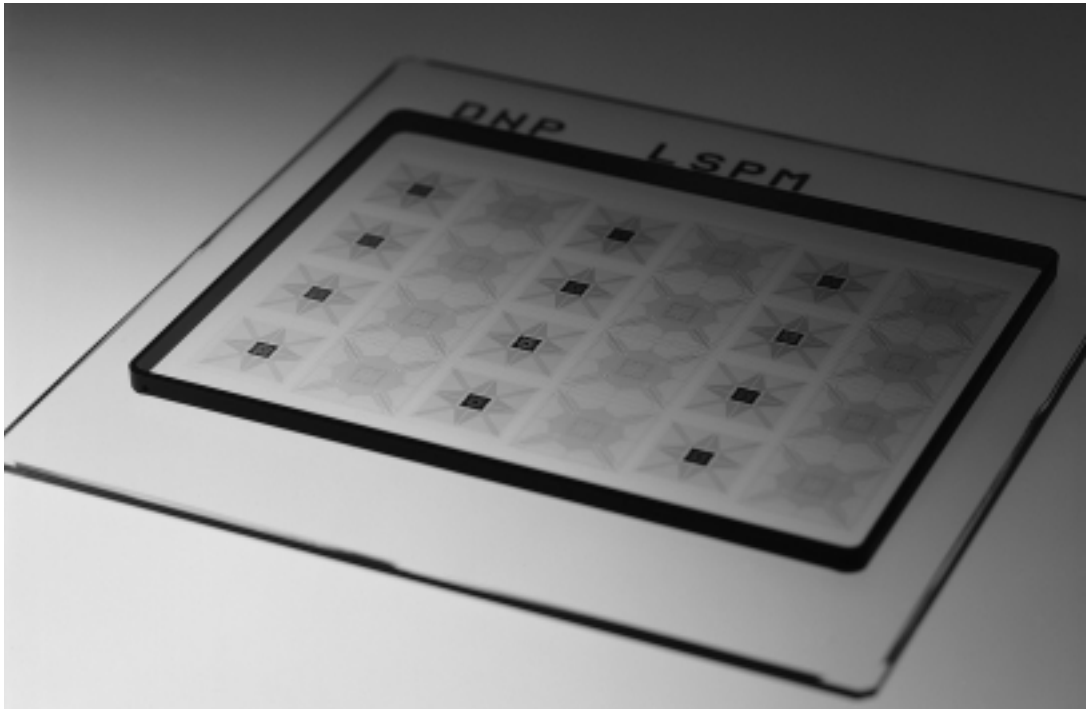
【主な仕様】

- 基板サイズ：Max.800mm
- ガラス材質：QZ、ソーダライム
- 膜質：2層膜（表面低反射）、濃度3.0以上
- 寸法：±0.5 μm以下
- トータルピッチ：±1.0 μm以下

【主な用途】

- ビルドアップ基板
- フレキシブル基板
- TAB基板

9インチフォトマスク（ペリクル装着）



DNP
大日本印刷株式会社

電子デバイス事業部 事業企画部
〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町1-1-1
TEL : 03-3266-2397
FAX : 03-3266-2759
<http://www.dnp.co.jp/semi/>